

上海新阳半导体材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

根据本公司 2014 年第二次临时股东大会决议及 2015 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]127 号）的批准，本公司于 2016 年 3 月在深圳证券交易所以每股 27.98 元的价格非公开定向增发方式发行股票，共计发行人民币普通股 1,072.1944 万股。该次向社会非公开发行股票共募集资金人民币 299,999,993.12 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 7,896,226.28 元后，实际募得资金为人民币 292,103,766.84 元。上述资金已于 2016 年 3 月 21 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 25 日出具了众会字（2016）第 3065 号《验资报告》。

公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定在银行开设了募集资金存储专户，分别为开户行：上海银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海银行松江支行”）账号为 03002836261；开户行：中国建设银行股份有限公司上海荣乐支行（以下简称“建行松江支行”），账号为 31050180400000000039。

上述两个募集资金账户存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额（元）	截止日余额
中国建设银行股份有限公司上海荣乐支行	31050180400000000039	142,103,766.84	已销户
上海银行股份有限公司松江支行	03002836261	150,000,000.00	已销户
合计		292,103,766.84	

本公司于 2018 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议、于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过将尚未使用的募集资金及利息 19,900.29 万元变更用途，其中 16,000.00 万元变更用于投资新设立的子

公司上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“上海芯刻微公司”）实施“193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目”，剩余募集资金及存款利息 3,900.29 万元用于永久补充公司流动资金。并同意本公司注销原建行上海荣乐支行及上海银行松江支行募集资金专用账户。

同时，本公司及子公司上海芯刻微公司分别在上海银行松江支行开设账号为 03003614556 及 03003620278 的募集资金专用账户。该专户仅用于子公司上海芯刻微公司进行“193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目”，不得用作其他用途。本公司、上海芯刻微公司于 2018 年 6 月与保荐机构、上海银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

截止 2020 年 6 月 30 日，新开立的两个募集资金得存储情况列示如下：

募集资金存放银行	相应公司	银行帐号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)
上海银行松江支行	本公司	03003614556	110,000,000.00	66,452,735.96
上海银行松江支行	上海芯刻微公司	03003620278	50,000,000.00	6,209,420.78
合 计			160,000,000.00	72,662,156.74

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			29,210.38			已累计使用募集资金总额			22,324.27	
变更用途的募集资金总额			19,210.38			各年度使用募集资金总额			22,324.27	
						其中：2016年：10,000.00				
						2017年：0.00				
						2018年：8,210.38				
变更用途的募集资金总额比例			65.77%			2019年：1,886.28				
						2020年：2,227.61				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	用状态日期 (或截止日项目完 工程度)
1	集成电路制造用 300mm 硅片技术 研发与产业化	集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化	29,210.38	10,000.00	10,000.00	29,210.38	10,000.00	10,000.00	-	已置换
2	300mm 硅片技术 研发与产业化	193nm(ArF)干法光刻 胶研发及产业化项目	-	16,000.00	9,113.89	-	16,000.00	9,113.89	6,886.11	项目尚未达到可 使用状态
3		永久补充流动资金	-	3,210.38	3,210.38	-	3,210.38	3,210.38	-	不适用
	承诺投资项目小计		29,210.38	29,210.38	22,324.27	29,210.38	29,210.38	22,324.27	6,886.11	

(二) 前次募集资金投资项目变更情况

变更项目名称	涉及金额 (万元)	占募集资金 总额的比例	变更原因	变更程序	批准机构	披露情况
193nm(ArF)干法光刻 胶研发及产业化项目	16,000.00	54.78%	注	2018年3月30日 召开2018年第一 次临时股东大会	股东大会	已对外公告
永久补充流动资金	3,210.38	10.99%				
合计	19,210.38	65.77%				

注：原项目集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化实施主体为本公司参股公司上海新昇半导体科技有限公司，本公司拟通过对上海新昇半导体科技有限公司增资的方式投入募集资金。后因该参股公司的股权经过多次变动，本公司不可能再取得对其的控制权。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，募集资金应由上市公司直接或由上市公司控制的企业使用，本公司不能再使用募集资金对上述项目进行投资。截止变更日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 10,000.00 万元，该金额业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 28 日所出具的众会字（2016）第 3305 号《鉴证报告》鉴证。

2018 年 6 月 8 日，公司将尚未使用的募集资金及利息 19,900.29 万元变更用途，其中 16,000.00 万元变更用于投资新设立的子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司（以

下简称“上海芯刻微公司”）实施“193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目”，剩余募集资金及存款利息 3,900.29 万元用于永久补充公司流动资金。

2019 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了“关于调整光刻胶项目由上海芯刻微实施为由上海新阳和上海芯刻微共同实施”的议案，本公司考虑到上海芯刻微公司作为全资子公司成立时间短、底子薄，而光刻胶项目投入大、收效慢；剩余的募集资金不足以支撑其前期的巨大投入，其也很难独立进行市场融资；又因其没有前期从业经验积累也会使产品验证环节受到客户端的限制等不利于光刻胶项目进程的因素。因此为了方便募集资金使用和管理决定将今后对尚未划给该子公司的募集资金支出可以直接从本公司账号为 03003614556 的募集资金专项账户支付，原留存在上海芯刻微公司专户资金继续由其使用。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司原持有上海新昇半导体科技有限公司（以下简称上海新昇公司）27.56% 股权，其中 1 亿元系募集资金，其他资金为公司自筹资金。2019 年，本公司与上海硅产业集团股份有限公司签署《发行股份购买资产协议》及相应补充协议，将持有的 26.06% 上海新昇公司股权置换为上海硅产业集团股份有限公司新增发的 139,653,500 股股票，交易对价为 48,231.18 万元。相应股权完成交割后，本公司认为该交易具有商业实质并依据《非货币性资产交换》准则确认置换收益。交易完成后本公司仍持有上海新昇公司 1.5% 的股权且按《长期股权投资》准则将剩余股权按置换日的公允价值重新计量，并将与账面价值之间的差额计入损益。2019 年本公司因该资产置换合计确认投资收益 308,038,812.15 元。处理如下所示：

换出资产			换入资产	确认投资收益
项目	账面价值（元）	公允价值（元）		
上海新昇公司 26.06% 股权	191,038,525.52	482,311,800.00	上海硅产业集团股份有限公司 139,653,500 股股票	291,273,274.48

丧失重大影响之日交易处理如下所示：

项目	账面价值	公允价值	确认投资收益
上海新昇公司 1.5%股权	10,996,077.83	27,761,615.50	16,765,537.67

目前上海硅产业集团股份有限公司已在科创板挂牌上市。

（四）闲置募集资金情况说明

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司未将临时闲置募集资金用于其他用途，尚未使用的

募集资金情况如下：

序号	公司名称	开户银行	账号	期末余额
1	上海新阳半导体材料股份有限公司	上海银行松江支行	03003614556	66,452,735.96
2	上海芯刻微材料技术有限责任公司	上海银行松江支行	03003620278	6,209,420.78
合计				72,662,156.74

变更后募集资金拟对“193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目”投入 16,000.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已累计使用 91,138,908.68 元。

本公司将尚未使用的募集资金合计 68,861,091.32 元，累计产生利息收入 3,801,065.42 元，余额合计 72,662,156.74 元，均存放于募集资金专项账户中。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-6月		
1	集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化	不适用	不适用	-684.00	279.61	0.00	0.00	-869.28 ^{注1}	否
2	193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目	不适用	不适用	0.00	-199.99	-1,150.07	-1,068.84	-2,418.90 ^{注2}	否
3	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：本报告中披露的关于集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化投资项目相关效益的计算截止日期为2018年6月30日，因公司已于2018年第二季度完成原计划投向上述项目的募集资金的用途变更事宜。该项目未达到预计效益主要系该项目已置换为193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目。

注2：本报告期内披露的关于193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目相关效益计算包含自有资金投入。该项目未达到预计效益主要系项目尚未达到可使用状态。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在发行股份购买资产的情况。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

上述前次募集资金实际使用情况与本公司对外信息披露文件中披露的有关内容一致。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2020年8月13日